

Title (en)
Coating apparatus and coating method

Title (de)
Beschichtungsanlage und Beschichtungsverfahren

Title (fr)
Appareil et procédé de revêtement

Publication
EP 1816228 A1 20070808 (DE)

Application
EP 06000641 A 20060112

Priority
EP 06000641 A 20060112

Abstract (en)
A coating installation (1) comprises a treatment chamber (3) having its walls (11) and inside tempered with a temperature of 45-75[deg]C and pre-chambers (4, 5) arranged next to the treatment chamber for thermally pre-treating workpieces to be coated. An independent claim is also included for coating workpieces using the above installation.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Beschichtungsanlage (1), insbesondere Niederdruckplasmabeschichtungsanlage (2), mit mindestens einer Behandlungskammer (3) und einem Beschichtungswerkzeug (9), insbesondere einer Plasmaspritzvorrichtung, wobei mindestens eine Pumpe (zweite Pumpe 14) zur Evakuierung der Behandlungskammer (3) vorgesehen ist, welche Behandlungskammer (3) temperierbar ausgebildet ist. Daneben ist ein Beschichtungsverfahren zur Niederdruckplasmabeschichtung mit einer temperierten und evakuierten Behandlungskammer (3), in welcher ein Werkstück (12) mittels mindestens eines Beschichtungswerkzeugs (9) beschichtet wird. Zur Beschleunigung des Beschichtungsvorgangs, insbesondere des Evakuierens der Behandlungskammer wird vorgeschlagen, dass zumindest die Wände (11) der Behandlungskammer (3) und/oder das Innere der Behandlungskammer (3) auf eine Temperatur zwischen 45°C und 75°C temperiert sind.

IPC 8 full level
C23C 4/12 (2006.01); **B05B 7/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C23C 4/02 (2013.01 - EP US); **C23C 4/134** (2016.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] DE 2630507 A1 19780112 - MTU MUENCHEN GMBH [DE]
- [X] DE 4135326 C1 19930609
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 24 11 May 2001 (2001-05-11)
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 07 3 July 2002 (2002-07-03)

Designated contracting state (EPC)
CH DE GB IT LI

Designated extension state (EPC)
AL BA HR MK YU

DOCDB simple family (publication)
EP 1816228 A1 20070808; US 2007186848 A1 20070816

DOCDB simple family (application)
EP 06000641 A 20060112; US 65320207 A 20070112